

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

佛山市蓝箭电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年4月30日（周二）下午 15:00~16:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、蓝箭电子 董事、总经理袁凤江 2、蓝箭电子 董事、副总经理、财务总监赵秀珍 3、蓝箭电子 副总经理、董事会秘书张国光 4、独立董事付国章 5、保荐代表人刘绿璐 6、保荐代表人卢丹琴
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、请问公司 2023 年年度及 2024 年一季度业绩下滑的主要原因是什么？</p> <p>尊敬的投资者，您好。2023 年以来，主要是受国内外经济形势变化和下游消费类电子产品等市场需求的变化，以及叠加下游客户处于去库存阶段的综合影响，市场竞争加剧使得公司产品销售价格下滑，导致利润和销售收入同比有所下降。面对半导体封测行业激烈竞争的态势，公司将着眼行业前瞻性，坚持稳中求进策略，提升技术研发水平。公司将进一步拓宽产品应用面，丰富产品系列，优化产品结构，推动产品迭代升级，集中资源攻关汽车电子、工控类等高附加值产品，稳步提升公司业绩。感谢您的关注。</p> <p>2、当前监管部门对上市公司现金分红情况加强监管，公司在 2023 年度利润分配预案为每 10 股派发现金 2.8 元，是否对公司未来经营的现金流造成不利影响？</p>

尊敬的投资者，您好，公司积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营成果，在保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，坚持实施现金分红。公司2023年年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.8元(含税)。本次现金分红综合考虑了公司战略发展目标及流动资金需求，不会对未来经营带来不利影响。公司将继续践行“以投资者为本”的理念，坚守长期主义，坚持现金分红政策，同时持续关注公司的投资价值，努力成为一家长期回报股东、回馈社会的优质上市公司。谢谢！

3、请问公司现有的产品布局是怎样的？

尊敬的投资者，您好。公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。从产品类别看，公司封装产品包括二极管、三极管、场效应管等分立器件产品和电源管理IC等模拟电路产品。从下游应用领域看，公司主要产品应用于消费类电子、工业控制、智能家居、安防、网络通信、汽车电子等多个领域。感谢您对公司的关注。

4、请问保荐机构是否持续监督公司对募集资金使用的检查和监督？

尊敬的投资者您好，我们保荐机构持续督导的期间为公司上市当年剩余时间及其后3个完整会计年度，在持续督导期内我们对募集资金的使用进行检查和监督，每半年进行一次现场检查。谢谢。

5、请问公司在维护股东利益方面，有何积极举措？

尊敬的投资者您好，公司通过持续完善内部控制制度，增强公司治理的合规管理，不断提高信息披露质量，积极落实利润分配政策，维护股东特别是中小股东的利益。感谢您对公司的关注。

6、请问公司募投项目的进展情况及预计投产时间？

尊敬的投资者您好，公司首次公开发行股票募集资金承诺投资于半导体封装测试扩建项目和研发中心建设项目，截至2023年12月31日，半导体封装测试扩建项目累计投入约4.1亿元，投资进度75.73%，研发中心建设项目累计投入约351万元，投资进度为6.09%，项目预计达到可使用状态日期为2024年12月31日。公司按照相关法律法规、规范性文件的有关规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，详细进展情况请参考公司披露的定期报告。感谢您的关注。

7、请问公司股票是否参与转融通和融券

尊敬的投资者您好，公司融券及转融通业务情况详见定期报告的相关信息，感谢您对公司的关注。

8、请问总经理，二级市场上投资者一直用脚投票，请问公司有何考虑吗？

尊敬的投资者，您好。股价波动受较多因素影响，公司一直致力于中小投资者的回报，感谢您的关注。

9、想问下总经理，今年公司有出海的计划吗？是否有考虑拓展海外市场？

尊敬的投资者，您好，感谢您对公司的关注，公司的业务规划请参见公司的公告信息，谢谢。

10、请问董事长，二级市场上投资者一直用脚投票，请问公司有何考虑吗？

尊敬的投资者，您好。股价波动受较多因素影响，公司一直致力于中

小投资者的回报，感谢您的关注。

11、因为我深度套牢，请问 2024 企业发展规划，是否能扭亏，好坚定我持股信心

尊敬的投资者，您好，未来规划请您关注公司披露的公告，谢谢。

12、请问公司有无引入国资投资公司计划？

尊敬的投资者，您好，公司目前暂无相关计划，谢谢。

13、目前是电车时代，公司有没有进行相关研发业务跟进

尊敬的投资者，您好！公司从事半导体封装测试业务，从下游应用领域看，公司主要产品应用于消费类电子、工业控制、智能家居、安防、网络通信、汽车电子等多个领域，相关业务与研发的具体情况请参见公司发布的公告，感谢您对公司的关注。

14、请问公司上市以来股价跌幅严重，公司有无市值管理计划，向百亿市值进军？

尊敬的投资者，您好。股价波动受较多因素影响，感谢您的关注。

15、股价暴跌，公司下一步如何看？

尊敬的投资者，您好。股价波动受较多因素影响，感谢您的关注。

16、能说句实话吗

尊敬的投资者您好，感谢您的关注。

17、芯片外购是否会对公司经营稳定性产生很大风险？如果有何应对措施？

尊敬的投资者，您好，公司外购芯片不会对公司经营稳定性产生很大风险，公司与行业主要的芯片供应商建立了长期而稳定的合作关系，可保障芯片供应的持续和稳定。感谢您的关注，谢谢。

18、你好，公司管理层，您们如何看待半导体产业的规模及发展趋势？蓝箭现在在半导体封装测试行业所处的行业地位如何？

尊敬的投资者，您好，半导体产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业。具体的产业规模及发展趋势以及行业地位情况请参见公司已披露的相关公告，感谢您对公司的关注，谢谢。

19、先把股价稳上去吧，都跌成啥样了

尊敬的投资者，您好，感谢您的关注。

20、请问公司是否与华为有合作或间接合作

尊敬的投资者，您好！公司主营业务、应用领域与客户关系已遵循相关规定披露，具体信息请参见公司发布的公告，谢谢！

21、666

尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注与支持，谢谢。

22、张董秘，蓝箭电子有哪些产品能用于无人机、机器人领域？您预计未来该下游应用能给公司带来多大的成长空间？

尊敬的投资者，您好！公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。从产品类别看，公司封装产品包括二极管、三极管、场效应管等分立器件产品和电源管理 IC 等模拟电路产品。从下游应用领域看，公司主要产品应用于消费类电子、工业控制、智能家居、安防、网络通信、汽车电子等多个领域。具体应用信息请参见公司发布的公告，感谢您对公司的关注。

23、请问公司扩产项目开始投入生产了吗？谢谢

尊敬的投资者，您好，公司募投项目正在建设中，相关进展请参见公司已披露的相关公告，谢谢！

24、上市业绩就变脸，怎么举报啊？

尊敬的投资者您好，受市场、行业等多种客观因素影响，公司经营所面临的挑战与机遇相并存，有关业绩情况请您关注公司披露的定期报告，感谢您对公司的关注，谢谢。

25、一季度亏损除了竞争激烈，是否还有一个原因是原材料储备过多导致

尊敬的投资者，您好，一季度的相关情况请参见公司披露的定期报告，感谢您的关注。

26、去年公司的研发费用下降了 25.94%，主要是什么原因？是否会影响公司的技术创新和市场竞争能力？

尊敬的投资者，您好。公司的研发投入的变化主要受公司研发周期变动的影 响。未来，公司将紧跟行业研发热点，将技术创新作为自身发展的重要驱动力。感谢您对公司的关注。

27、请问袁总，公司上市以来股价跌幅严重，请问有无市值管理计划？

尊敬的投资者，您好。股价波动受较多因素影响，感谢您的关注。

28、贵公司在年报中提到了数字化转型和新兴领域的发展机遇，那么请问公司在这些领域的具体布局和未来规划是什么？

尊敬的投资者，您好。公司在相关领域的布局和未来规划请您关注公司披露的公告，谢谢。

29、领导，您好！我来自四川大决策，公司在先进封装领域，有哪些具体布局？

尊敬的投资者，您好。公司目前已通过自主创新在封测全流程实现智能化、自动化生产体系的构建，具备 12 英寸晶圆全流程封测能力，在功率半导体、芯片级贴片封装、第三代半导体等领域实现了科技成果与产业的深度融合；先进封装系列主要包括 DFN/PDFN/QFN、TSOT 和 SIP 等。具体信息请参见公司发布的公告，谢谢！

30、为什么公司不披露前 5 大客户？年报披露显示美的集团、视源股份、格力电器都是公司长期的客户，请问老客户每年业务是否有递增？

尊敬的投资者，您好，公司按照创业板年报信息披露的内容与准则要求 进行披露，感谢您的关注。

31、年报里提到公司已形成年产超 150 亿只半导体的生产规模，请问公司目前订单充足吗？2023 年实际的年产量是多少？

尊敬的投资者您好，目前公司订单充足，具体相关信息请关注已披露的相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢。

32、请阐明 2024 年利润规划

尊敬的投资者，有关业绩情况请您关注公司披露的定期报告，感谢您对公司的关注，谢谢。

33、袁总您好，公司 2023 年的净利润下滑这么多，一季度还亏损了，还能期待公司今年的业绩表现吗？

尊敬的投资者，您好，公司受市场、行业等多种客观因素影响，公司经营所面临的挑战与机遇相并存，有关业绩情况请您关注公司披露的定期报告，感谢您对公司的关注与支持，谢谢。

	<p>34、请问财务总监赵总，上市之前账目做那么漂亮，为什么上市不到一年就变脸？</p> <p>尊敬的投资者，您好，公司受市场、行业等多种客观因素影响，公司的营业收入及利润情况有所波动，有关业绩情况请您关注公司披露的定期报告，感谢您对公司的关注，谢谢。</p> <p>35、建议公司业务转型，目前业务毫无市场竞争力，毛利润低的可怜</p> <p>尊敬的投资者，您好，非常感谢您提出的宝贵建议。公司专业从事半导体的封装测试，多年来深耕半导体封装测试领域。公司持续在努力经营好主营业务，确保营收稳定前提下，同时也在积极寻找合适的发展路径，以应对市场变化和行业竞争。谢谢您。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年04月30日